

## 平成 28 年度 第 5 回 フジコ・ミーティング資料

日 時： 平成 29 年 2 月 16 日 (木) 13:00 ~ 17:30  
場 所： 奥野製薬工業株式会社 総合技術研究所 西棟会議室 3F  
大阪市鶴見区放出東 1 丁目 10 番 25 号

- |           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 1) あいさつ   | 13:00 ~ 13:20 | 奥野製薬工業株式会社 総合技術研究所<br>所長 大塚 邦顕 氏<br><br>公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター<br>副センター長 野北 寛太   |
| 2) 講演     | 13:20 ~ 13:50 | 「M-SAP 工法に最適なビアフィリング硫酸銅めっき添加剤」<br>奥野製薬工業株式会社 表面技術研究部 第一研究室<br>室長 小倉 英稔 氏  |
|           | 13:50 ~ 14:20 | 「サムコ株式会社の IoT 分野の取り組み<br>～非シリコン微細加工技術と AquaPlasma®を中心に～」<br>サムコ株式会社 製品技術部<br>部長 中野 博彦 氏   |
| 3) 研究進捗報告 | 14:20 ~ 15:30 | 「2 流体スピネッチング装置を用いた微細配線のシード層エッチング」<br>公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター<br>研究員 林 繁宏<br><br>「配線表面状態と信号品質の評価」<br>公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター<br>研究員 相島 博之<br><br>「表面処理技術の活用に関する三次元半導体研究センターの取り組み」<br>公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター<br>研究員 古橋 啓太 |
|           | 15:30 ~ 15:50 | (お一人 30 秒程度)  |
|           | 15:50 ~ 16:00 | 休憩  |
| 5) 工場見学   | 16:00 ~ 17:00 | (班に分かれて実施)  |
| 6) 名刺交換会  | 17:00 ~ 17:30 | (工場見学終了班より随時)   |